

	M2M MS1 卡产品说明 SLI 76CF3600P		
		页码：1	页数：5

M2M MS1(SLI 76CF3600P)卡产品说明

	M2M MS1 卡产品说明 SLI 76CF3600P		
		页码： 2	页数： 5

目 录

1. 编写目的.....	1
2. 产品概述.....	1
2.1 物理指标	1
2.2 指令指标	1
2.3 鉴权指标	1
2.4 文件系统指标	1
3. 硬件指标.....	1
3.1 擦写次数	1
3.2 数据保存时间	1
3.3 操作温度(包括工作温度和存储温度)	1
3.4 湿度	1
3.5 静电	1
3.6 电磁	1
3.7 X光(紫外线)	1
3.8 震动	1
4. SIM外形	1

	M2M MS1 卡产品说明 SLI 76CF3600P		
		页码：3	页数：5

1. 编写目的

本文是中国移动 64K M2M MS1 卡产品说明书，规定和描述了中国移动 64K M2M MS1 卡产品的物理要求，功能要求，性能要求以及文件系统要求，是开发中国移动 64K M2M MS1 卡产品的依据。

2. 产品概述

2.1 物理指标

符合《中国移动 m2m(u)sim 卡设备规范 v2.0.0》中要求；

2.2 指令指标

符合《GSM11.11》要求；

2.3 鉴权指标

符合《中国移动防克隆 SIM 卡技术规范 V2.0.0》中的要求

2.4 文件系统指标

符合《中国移动 m2m(u)sim 卡设备规范 v2.0.0》中《M2M 专用卡基本文件格式》要求；

基本号簿（ADN）：100；短消息（SMS）：20；

3. 硬件指标

3.1 擦写次数

50 万次；

3.2 数据保存时间

10 年；

3.3 操作温度(包括工作温度和存储温度)

-40 to +105°C；

3.4 湿度

在 85 度温度，相对湿度范围 90%~95%，1000 小时的条件下，可以保证卡的操作和存储正常；

3.5 静电

在卡暴露在 4000V 的静电环境中，不应降低卡片功能；

3.6 电磁

在卡暴露在稳定的 79500A/m（1000Qe）磁场下，不应降低卡片功能；

3.7 X 光(紫外线)

在卡的任何一面每边在受到 0.1Gy 剂量，相当于 70~140KeV 中等能量 X 射线照射时（一年的累计剂量），不应降低卡片功能；

3.8 震动

20Hz to 2000Hz;

4. SIM 外形

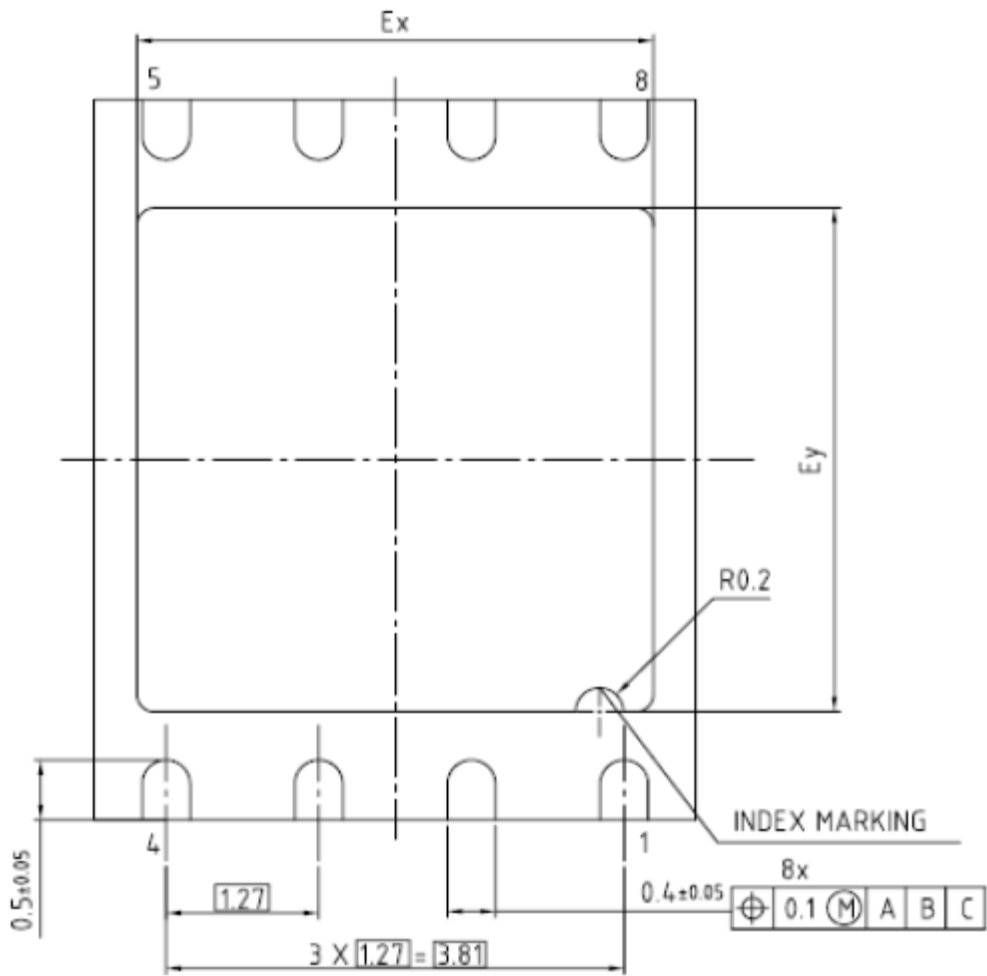


图 1 QFN5*6-8 封装芯片底视图

QFN5*6-8 芯片的 8 个管脚中，6 个管脚应与无线模块的相应设备相连，2 个管脚不用。下图为管脚定义：

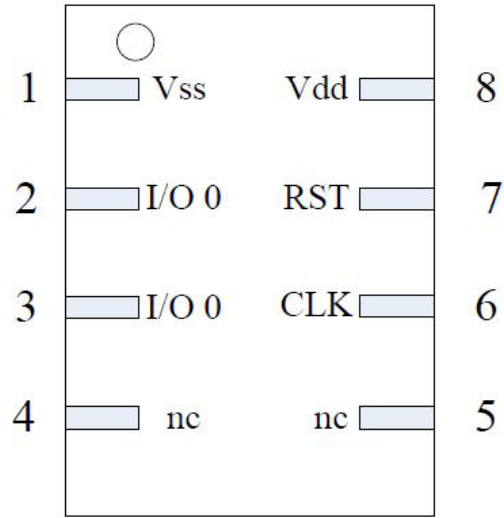


图 2 QFN5*6-8 封装芯片管脚定义

第 2 个和第 3 个管脚同时只有一个为 I/O 脚。在电路设计时，如果不明确，可以将这两个管脚直接相连。下表为管脚定义：

管脚序号	触点信号	解释
1	Vss	接地端口
2	I/O	数据输入和输出端
3	I/O	数据输入和输出端
4	NULL	未定义
5	NULL	未定义
6	CLK	时钟信号输入端
7	RST	复位信号输入端
8	Vdd	供电电压输入端

表 1 QFN5*6-8 封装芯片管脚定义列表